	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XP034F</b>	文件编号	临时
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	1/2

## 1 主要用途及主要特点

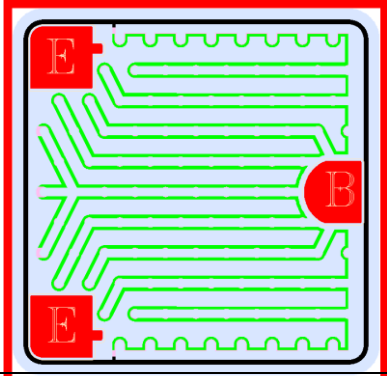
### 1.1 主要用途

用 W2XP034F 封装的成品管主要用于 MP3 的功放电路中。

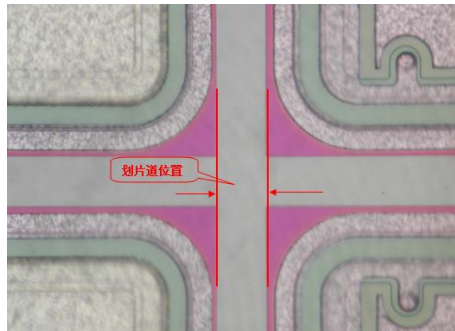
### 1.2 主要特点

- 饱和压降低
- 电流特性好

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.90×0.90	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20	
	划片道尺寸 (μm)	40	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基区	146×158
		发射区	158×158
	钝化层	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	3.6±0.4
	背面电极	金属	金
	硅片直径 (mm)	φ125	
	装片要求 (推荐)	共晶	

\* 划片道位置示意图:



## 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

### 3.1 极限值


除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	-50	V	推荐封装形式: SOT-23 推荐成品型号: FMMT720
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	-50	V	
发射极-基极电压	$V_{EB0}$	-5	V	
集电极电流	$I_C$	-2.0	A	
耗散功率( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	0.625	W	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

<b>江阴新顺微电子有限公司</b>	
地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号	网 址: <a href="http://www.xs-elec.com">http://www.xs-elec.com</a>
电 话: (0510) 86851182	传 真: (0510) 86851532

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W2XP034F</b>	文件编号	临时
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	2/2

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -50V, I_E = 0$			-1	$\mu A$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$			-1	$\mu A$
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_E = -2V, I_C = -100mA$	-300			
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_E = -2V, I_C = -2A$	-150			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CEsat}$	$I_C = -2A, I_B = -100mA$			-0.3	V
特征频率	$f_T$	$V_E = -10V, I_C = -50mA$ $f = 100MHz$	150			MHz

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度  $25 \pm 5^\circ C$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的芯片技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

<b>江阴新顺微电子有限公司</b>	
地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号	网址: <a href="http://www.xs-elec.com">http://www.xs-elec.com</a>
电 话: (0510) 86851182	传真: (0510) 86851532